DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

ok

Proposed Change：	☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ■4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/ 模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ☐8.Add second source 新增替代料 ☐9. Others 其他：_____	**Initiator：** Kane 0302 1110
Reason for Change：	CARDBOARD 用量變更.	**EC No：** EC26020401
Model / Part No.：	1A42160000 VM14.0 Display Module WH Badge ,1A42160001 VM14.0 Display Module GI Badge ,1A42160002 EPIQ CVx 24in Display Badge, Red ,1A42160003 EPIQ CV24in Name Badge for Inspira, Red ,1A42160004 VM15 27 OLED Display Name Badge.	**Issue Date：** 2026/2/4 **Requester Dept.：** DV11M003
Implementation Type：	■1. Immediately Change 立即切換 ☐2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	**Customer Approval：** (confirmed by PM) ☐Needed ☑Not needed

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	1A42160000 / 1A42160001 / 1A42160002 / 1A42160003 / 1A42160004	B	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007		31	
		A	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.026		31	
		B						
		A						
		B						
		A						

Comments 會簽意見

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Kane 0209 1450	Michael 0213 0800 Leslie 0211 1715	[signature] 0211 1700	Amber 0213 1050 [signature] 0212 0310	Estela 0212 1550	[signature] 0213 1600 Hanan 0213 1600	Terry 0223 1500 [signature] 0223	[signature] 0213 1100	[signature] 0213 1730 Joanne 0213 1700	[signature] 0223 [signature] 0223	Michael 0226 1010

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ☑No need	RD	
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☑No need	DQE	無影響
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ☑No need	RD	
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ■No	PE	無影響
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☑No need	DQE	無影響
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影響
7. Design FMEA （Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	RD	
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ☑No need	RD	
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ☑No need	RD	

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☑Yes ☐No need		工單300583, 2026.3.10更新用量.
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☐Yes ☑No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☑Yes ☐No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☐Yes ☑No need		
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		工單300583更新CARDBOARD用量.
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☑Yes ☐No need	PE	
12. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☑MDF ☑DMR ☑SOP ☐SIP ☐QC control plan ☐Approval Sheet ☐Engineering Spec ☐Others	☐Yes ☐No need	QA	

hsuan_wang

寄件者: hsuan_wang <hsuan_wang@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年1月28日星期三 下午 1:03
收件者: 'Kane_Huang@diva.com.tw'
副本: Ryan_Wang 王志維; Mary_Wang 王彥筑; Nick_Lin 林益銓; Laslie_Chen陳志偉; Amber_Tsao曹嘉雯; Lily_Chiu邱羽萱
主旨: Badge CARDBOARD用量變更

Dear Kane:

ACCESSORY BOX 1 unit=150 pcs ,BOX 內一層 30pcs ,需疊 5 層 ,故一 BOX 需 4 片 CARDBOARD.

以下表格內機種, CARDBOARD 用量由 0.007→0.026.

麻煩請幫忙 ECR 變更. 謝謝.

機種代碼	機種名稱	料號	料號品名	before 用量	after 用量
1A42160000	VM14.0 Display Module WH Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160001	VM14.0 Display Module GI Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160002	EPIQ CVx 24in Display Badge, Red	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160003	EPIQ CV24in Name Badge for Inspira, Red	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160004	VM15 27 OLED Display Name Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026

Warm regards,

Hsuan Wang 王世炫

DIVA Laboratories, Ltd. | 工程課 Dep.
T:+886-2-2226-8631#726 | E: hsuan_wang@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw

9F., No.351, Sec.2, Zhongshan Road, Zhonghe

設計變更審查會議記錄

時間：	20260204	地點：	801	主席：	世炫

參與人員： Kane、Amber、Killy、NicK

討論與決議事項：

ACCESSORY BOX 1 unit=150 pcs ,BOX內一層30pcs ,需疊5層 ,故一BOX需4片 CARDBOARD.
以下表格內機種, CARDBOARD用量由0.007變更為0.026。
麻煩請幫忙ECR變更, 謝謝。

機種代碼	機種名稱	料號	料號品名	before用量	after用量
1A42160000	VM14.0 Display Module WH Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160001	VM14.0 Display Module GI Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160002	EPIQ CVx 24in Display Badge, Red	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160003	EPIQ CV24in Name Badge for Inspira, Red	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026
1A42160004	VM15 27 OLED Display Name Badge	3MD095PK010	CARDBOARD (L355*W275,B FLUTE)	0.007	0.026

人員簽到：

變更號碼：EC

機種名稱：

1A42160000 VM14.0 Display Module WH Badge ,
1A42160001 VM14.0 Display Module GI Badge ,
1A42160002 EPIQ CVx 24in Display Badge, Red ,
1A42160003 EPIQ CV24in Name Badge for Inspira, Red ,
1A42160004 VM15 27 OLED Display Name Badge.

設計變更原因： Factory change工廠變更

設計變更描述： CARDBOARD 用量變更

導入時程：Normal

客戶審查：Not Need

一、研發課評估：

單位	審查內容	附加文件
EE :	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
FW :	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
ME :	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
SW :	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
DQE :	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無

二、結論：

1.LABELS UPDATE.

2.開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預:

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容,無關產品性能影響
可用性	無影響,沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查,沒有影響法規內容